

「半導体アプリケーションチッププロジェクト
(情報家電用半導体アプリケーションチップ技術開発)」評価委員会
(平成 19 年度までに終了した個別テーマの事後評価)

テーマ別事後評価報告書の構成について (案)

1. テーマ別事後評価報告書の目次

下記目次 (案) の第 1 章を評価委員会でまとめる。

目次 (案)

はじめに
委員名簿
審議経過

第 1 章 評価

1. 個別テーマに関する評価結果

- 1.1 リアルタイム情報家電用マルチコア技術の研究開発
- 1.2 情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発
-
- 1.9 FeRAM/FD-SOI 混載アプリケーションチップの研究開発

第 2 章 評価対象テーマの内容

- 2.1 リアルタイム情報家電用マルチコア技術の研究開発
- 2.2 情報家電用マルチメディアセキュアチップ TRON-SMP の研究開発
-
- 2.9 FeRAM/FD-SOI 混載アプリケーションチップの研究開発

参考資料

- 1. 評価の実施方法
- 2. プロジェクト説明資料
- 3. プロジェクト全体に対するコメント
- 4. 被評価者意見

2. 第1章のまとめ方

各個別テーマ毎に以下のように各委員の評点、及びコメントを取りまとめる。

第1章の取りまとめ方の例（案）

例：

1.1 ○○○の研究開発

実施者：○○社

評価項目	平均値
[1] 研究開発成果について	
[2] 実用化、事業化の見通しについて	

評価委員の評点の平均値を記載

(1) 総合評価

評価委員の意見を取りまとめて作成した文章。10行程度。

(2) 研究開発成果に関する評価

(肯定的意見)

各委員の生の意見（無記名）

(問題点・改善すべき点)

各委員の生の意見（無記名）

(その他の意見)

(3) 実用化、事業化の見通しに関する評価

(肯定的意見)

各委員の生の意見（無記名）

(問題点・改善すべき点)

各委員の生の意見（無記名）

(その他の意見)